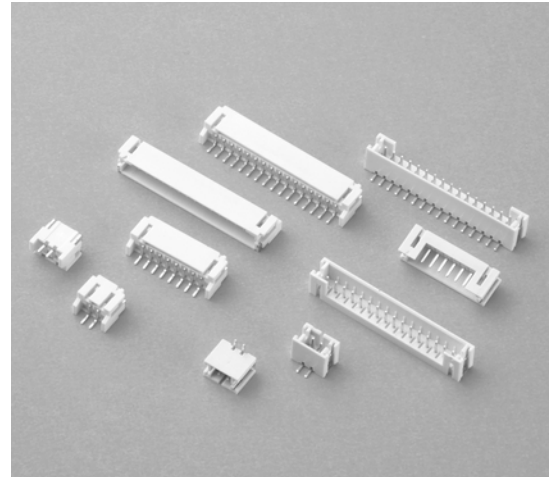


## SMT-Crimp-Rast-Stiftleisten RM 2,00mm, stehend/liegend SMT Friction Lock Pin Headers, 2.00mm Pitch, Vertical/Horizontal

### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 22 ... 28 <i>AWG 22 ... 28</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>&lt; 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>&gt; 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	800V <sub>AC</sub> <i>800V<sub>AC</sub></i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100V <sub>AC</sub> <i>100V<sub>AC</sub></i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A <i>1A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25°C ... +85°C <i>-25°C ... +85°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>

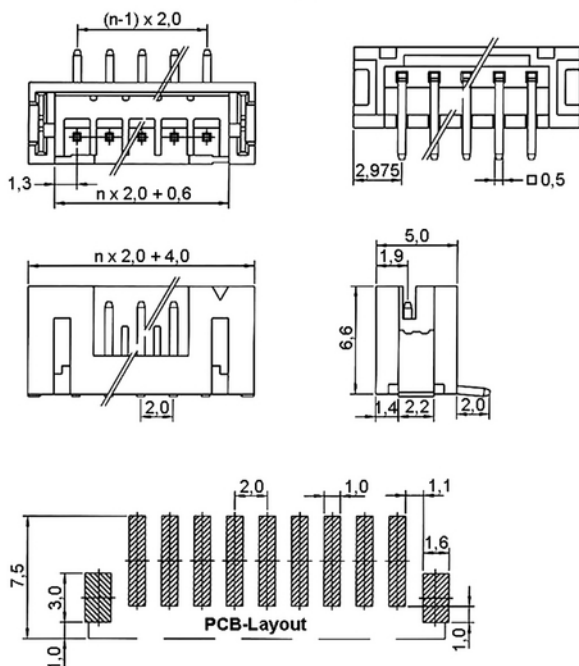


© W+P PRODUCTS

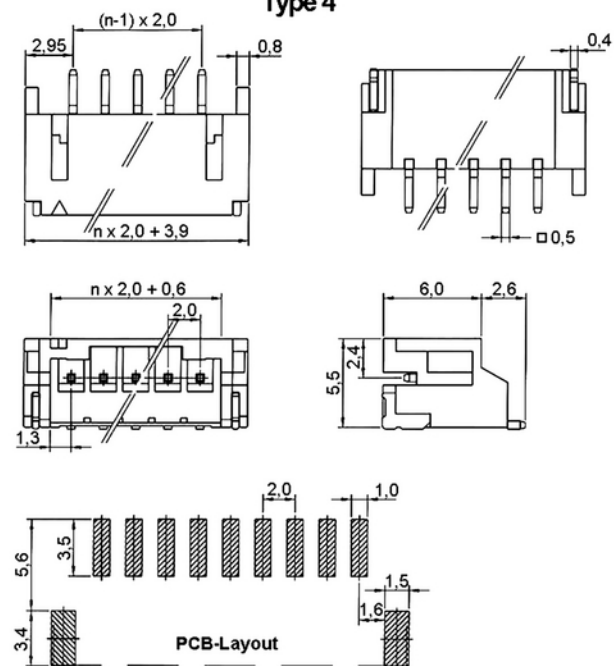
Passende Buchsengehäuse Serie:  
Mates with Housing Series:

521

**Type 3**



**Type 4**



Series	Contacts*	Type*	Plating	Packaging*
<b>5210</b>	<b>02</b> 02-16	<b>3</b> 3 Stiftleiste stehend Vertical pin header 4 Stiftleiste liegend Horizontal pin header	<b>50</b> 50 Verzinkt Tin plated	<b>PPTR</b> ST TR PPTR PPST

### Lieferformen / Packaging Options:

- ST In Stangen ohne Pick&Place-Pad / In tubes w/o Pick&Place-Pad
- TR Tape & Reel ohne P&P-Pad / Tape & Reel w/o P&P-Pad
- PPTR Tape & Reel mit P&P-Pad / Tape & Reel with P&P-Pad
- PPST In Stangen mit P&P-Pad / In tubes with P&P-Pad

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
FAX +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL sales@wpro.com  
WEBSITE www.wpro.com

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

